国机精工集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026—044

投资者关系活动类别	☑特定对象调研　　☐分析师会议 ☐媒体采访　　☐业绩说明会 ☐新闻发布会　　☐路演活动 ☐现场参观　　☐电话会议 ☐其他
参与单位名称及人员姓名	东吴证券：吴劲草、张寅瑜 长城证券：汪湛帆 西南证券：王梓溢、刘采薇 天风证券：任康 银华基金：王一川、蒋婉莹、曹瑞 天弓投资：白昊龙
时间	2026 年 11 月 13 日
地点	国机精工会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：赵祥功 投资者关系助理：汪智婷
投资者关系活动主要内容介绍	**1.问：怎么看待公司轴承业务未来发展情况？** 答：上半年轴承业务实现营业收入 8.15 亿元，同比下降 17.63%，主要受风电行业周期性变化影响。 航天特种轴承作为公司盈利的“压舱石”，传统优势地位持续稳固。产品全面覆盖卫星、运载火箭全系统关键部位，国内主流航天企业均为公司客户。可重复使用运载火箭方面，有力保障长征十号乙等国家重大航天工程任务顺利实施，配套朱雀三号重复使用遥二运载火箭完成发射与回收任务验证。随着商业航天进入常态化高频发射阶段，相关业务正逐步为公司带来新的增量。 **2.问：超硬材料磨具业务在半导体领域的开展情况？** 答：近几年，得益于我国半导体产业的发展，公司应用在半导体领域的产品保持较快增长势头，上半年同比增速约 40%，未来增长空间大。公司已形成“金刚石工具+精密陶瓷制品”的产品布局，覆盖倒边轮、减薄砂轮、划片刀、封装刀及陶瓷载盘、陶瓷吸盘、真空卡盘、静电卡盘等产品，贯穿半导体晶圆制造到封装测试全流程，客户

	覆盖国内主流晶圆厂、封测厂与设备厂商。 **3.问：公司金刚石工具业务的情况？** 答：公司在半导体领域金刚石工具产品上处于行业领先地位，主要包括划片刀、封装刀、减薄砂轮等产品，用于晶圆减薄、芯片划切与封装测试环节，是目前公司超硬磨具业务最核心的增长来源。该类产品与海外龙头仍存在差距，公司将持续加大技术研发投入，迭代优化提升产品性能。 **4.问：公司精密陶瓷制品业务的情况？** 答：公司在半导体领域精密陶瓷产品上处于行业领先地位，该类产品包括陶瓷载盘、陶瓷吸盘、真空卡盘、静电卡盘等。应用在半导体领域的精密陶瓷制品，技术开发难度大，产品技术壁垒较高，市场前景好，是公司未来几年重点推广的产品，公司将加快其市场导入，持续提升市场占有率。 **5.问：公司在金刚石功能化应用业务上有何优势？** 答：金刚石功能化应用是公司面向未来的战略赛道，目前已覆盖单晶金刚石、多晶金刚石、金刚石铜复合材料三条技术路线与产能布局，整体处于行业先进水平。 装备端自主可控，公司 MPCVD 设备全部自研自制，拥有新型高功率 MPCVD 法大尺寸金刚石生产线。标准端引领行业，牵头编制国内首个《热沉用金刚石片》团体标准，填补行业技术规范空白。应用端持续突破，散热片、光学窗口片等产品已配套国防领域重大工程；民用领域覆盖高功率芯片、IGBT（晶体管）、消费电子等应用场景，相关产品正与下游头部客户开展合作验证，积极推动应用落地。产业化支撑同步夯实，稳步推进产业园建设。 **6.问：公司半导体耗材的客户结构如何？** 答：公司半导体客户按产品类型分布较清晰。金刚石工具对应的客户集中于封装领域，精密陶瓷制品客户以半导体设备厂为主。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	否
活动过程中所使用的演示文	无

稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）	